

LMH13000 LiDAR およびタイムオブフライト (ToF) 向け、高速、電圧制御の電流出力レーザー ドライバを内蔵しています

1 特長

- 電圧制御電流ドライバ (電流シンク)
- 出力電流を 5mA から 5A までサポート
- 連続電流とパルス電流を駆動します
 - 立ち上がり時間 (t_r): 800ps 立ち上がり時間
 - パルス列: DC ~ 250 MHz
- 低電流モードと高電流モード
- IOUT に 18V の許容誤差を与えます
- LVDS、TTL、CMOS ロジックをサポート
- 広い電源電圧: 3V ~ 5.5V
- モノリシックレーザー ドライバを採用すると、外部 FET が不要になります
- サーマル・シャットダウンおよびパワーダウンを内蔵

2 アプリケーション

- ToF 範囲ファインダ
- 産業用光学センサ
- 3D スキャンとジェスチャ認識
- OTDR
- 高速電流負荷
- 産業用安全ライトカーテン
- 医療用 IVD とフロー サイトメトリー
- LIDAR モジュール

3 説明

LMH13000 は、間接的なタイムオブフライト (iToF) および直接飛行時間 (dToF) レーザー アプリケーションで正確

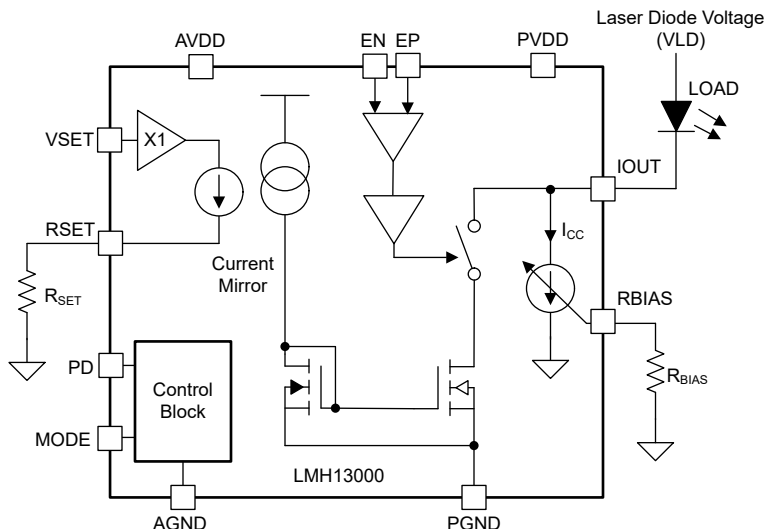
な電流制御を可能にする電圧制御電流源です。LMH13000 は、パルス電流出力アプリケーション向けに、外部 FET の必要なしに、 $< 1\text{ns}$ の高速な立ち上がり時間および立ち下がり時間をサポートします。LMH13000 は、エッジ発光レーザー (EEL)、垂直キャビティ表面放射レーザー (VCSEL) など、複数のレーザー タイプを駆動できます。VSET ピンは負荷電流を正確に調整し、レーザー ダイオードの温度変化や経年変化による変動を補正します。

LMH13000 は、周波数、デューティ サイクル、放熱に応じて、最大 1A の連続電流または 5A のパルス電流を供給します。LMH13000 は TI 独自の HotRod™ パッケージで供給されます。このパッケージを採用すると、内部ボンド・ワイヤが不要になり、高電流経路の非常に低いインダクタンスを実現でき、電流の立ち上がり時間と立ち下がり時間を短縮する設計が可能になります。ダイ温度が過剰になると、統合されたサーマル・シャットダウン機能がダイを保護します。LVDS 入力 (EP および EN) により、出力電流のオン時間、周波数、デューティ・サイクルを制御できます。LMH13000 は 3V ~ 5.5V で動作し、規定された動作周囲温度範囲は $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ (150°C の最大ダイ温度) です。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)
LMH13000	RQE (VQFN-HR, 13)	3.5mm × 3mm

- 詳細については、[セクション 10](#) を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



機能ブロック図



目次

1 特長.....	1	6.3 機能説明.....	15
2 アプリケーション.....	1	6.4 デバイスの機能モード.....	18
3 説明.....	1	7 アプリケーションと実装.....	19
4 ピン構成および機能.....	3	7.1 アプリケーション情報.....	19
5 仕様.....	4	7.2 代表的なアプリケーション.....	19
5.1 絶対最大定格.....	4	7.3 電源に関する推奨事項.....	25
5.2 ESD 定格.....	4	7.4 レイアウト.....	25
5.3 推奨動作条件.....	4	8 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	28
5.4 熱に関する情報.....	5	8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	28
5.5 低電流モードの電気的特性、MODE=0.....	5	8.2 サポート・リソース.....	28
5.6 高電流モードの電気的特性、MODE = 1.....	7	8.3 商標.....	28
5.7 代表的特性.....	8	8.4 静電気放電に関する注意事項.....	28
5.8 パラメータ測定情報.....	13	8.5 用語集.....	28
6 詳細説明.....	14	9 改訂履歴.....	29
6.1 概要.....	14	10 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	29
6.2 機能ブロック図.....	14		

4 ピン構成および機能

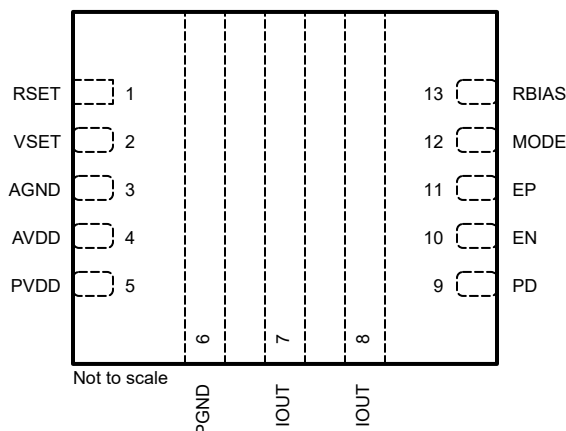


図 4-1. RQE パッケージ 13 ピン WQFN-HR (上面図)

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
番号	名称		
1	RSET	I	抵抗設定ピン。AGND に 20kΩ 抵抗を接続し、出力電流 I _{OUT} を設定します。
2	VSET	I	電圧設定ピン。電圧を印加し、I _{OUT} を設定 $I_{OUT} = V_{SET} / R_{SET} \times k$
3	AGND	P	信号グラウンド
4	AVDD	P	信号電源
5	PVDD	P	電源
6	PGND	P	電源グラウンド
7、8	IOUT	O	出力電流シンク
9	PD	I	パワーダウン入力: 0 = 通常動作 1 = パワーダウン
10	EN	I	負の LVDS 入力
11	EP	I	正の LVDS 入力
12	モード	I	出力電流モード選択 0 = 低電流 (5mA ~ 1A) 1 = 高電流 (250mA ~ 5A)
13	RBIAS	I	定電流設定抵抗。 IOUT に直流固定電流を流す場合は、AGND に抵抗を接続します。 AVDD に接続すると、無効になります。

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グラウンド、P = 電源。

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
AVDD	アナログ電源電圧		6	V
PVDD	電源電圧		6	V
V _{IOUT}	IOUT ピンの電圧		21.6	V
V _{SET}	VSET ピンの電圧	AGND	2.5	V
	EP、EN、PD、MODE、RSET、RBIAS	AGND	AVDD	V
	全入力ピン用入力クランプダイオード		±10	mA
T _J	接合部温度		150	°C
T _{stg}	保存温度	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲を超える動作は、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります。「絶対最大定格」は、「推奨動作条件」に記載された値を超える条件あるいは他のいかなる条件において、本デバイスの機能的な動作を定めたものではありません。「絶対最大定格」の範囲内で、一時的に「推奨動作条件」の範囲を超えた動作をさせる場合、必ずしもデバイスが損傷を受けるものではありませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命が短くなります。

5.2 ESD 定格

			値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM) ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	±2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に準拠 ⁽²⁾	±750	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
AVDD	アナログ電源電圧	3		5.5	V
PVDD	電源電圧	3		5.5	V
T _A	周囲温度	-40	25	125	°C
V _{SET}	IOUT 制御ピン、 $I_{OUT} = V_{SET}^{(1)} / R_{SET} \times k^{(2)}$	0.01		2	V
R _{SET}	RSET ピンに接続された抵抗		20		kΩ
	EP と EN の間の終端抵抗		100		Ω
LVDS ⁽³⁾	LVDS = 1 の V _(EP-EN)	100			mV
	LVDS = 0 の V _(EP-EN)			-100	

- (1) V_{SET} は、低電流モードと大電流モードの両方で、推奨動作条件を超えて調整することで、I_{OUT} の DC 誤差を補償またはキャリブレーションできます。

- (2) k の値については、セクション 5.5 およびセクション 5.6 を参照してください。

- (3) 高周波数および出力電流で信頼性の高いジッタフリー動作を実現するには、±250mV 以上を適用します。

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		LMH13000	単位
		RQE (VQFN-HR)	
		13 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	30	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	28	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	14.5	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	0.4	°C/W
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	14	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	1	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション レポートを参照してください。

5.5 低電流モードの電氣的特性、MODE=0

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $PVDD = AVDD = 5\text{V}$ 、 $RBIAS = AVDD$ 、 $MODE = 0$ 、 $PD = 0$ 、およびスナバという [図 5-31](#) (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
IOUT DC 性能							
I _{OUT}	可変電流 ⁽¹⁾	V _{SET} = 0.01V～2V	T _A = -40℃ ～ +125℃	0.005		1	A
	I _{OUT} の精度	I _{OUT} = 0.1A				±14.5	%
		I _{OUT} = 1A				±5.5	
	I _{OUT} 変動	I _{OUT} = 0.1A	T _A = -40℃ ～ +125℃			±3.5	%
		I _{OUT} = 1A	T _A = -40℃ ～ +125℃			±1	
MINV _{IOUT}	最小 V _{IOUT} ⁽²⁾	I _{OUT} = 0.1A	T _A = -40℃ ～ +125℃	0.7			V
		I _{OUT} =1A	T _A = -40℃ ～ +125℃	2.1			
I _{LEAK}	IOUT でのリーク電流	PD = 1 または LVDS = 0				170	nA
			T _A = -40℃ ～ +125℃			48	μA
MAXV _{IOUT}	最大 V _{IOUT}					18	V
IOUT の AC 性能 (R _{DAMP} = 1Ω、L _{LOAD} = 1nH)、 図 5-31 をご参照してください							
C _{IOUT}	IOUT インピーダンス	並列容量 ⁽³⁾		図 5-12 を参照してください			pF
L _{IOUT}	IOUT インピーダンス	直列インダクタンス ⁽⁴⁾		100			pH
	I _{OUT} ノイズ	I _{OUT} = 100mA 、積分帯域幅= 100MHz	T _A = -40℃ ～ +125℃	60			μA _{RMS}
t _r	I _{OUT} 立ち上がり時間	I _{OUT} = 1A、VLD = 4V		0.4			ns
			T _A = -40℃ ～ +125℃	0.5			
t _f	I _{OUT} 立ち下がり時間	I _{OUT} = 1A、VLD = 4V		0.3			ns
			T _A = -40℃ ～ +125℃	0.4			
	I _{OUT} オーバーシュート	I _{OUT} = 1A、VLD = 4V		23			%
	I _{OUT} アンダーシュート	I _{OUT} = 1A、VLD = 4V		10			%
	I _{OUT} セットリング タイム	I _{OUT} = 1A、10%セットリング		3			ns
VSET (I _{OUT} 制御ピン)							
	VSET 入力バイアス電流		T _A = -40℃ ～ +125℃	50			nA
	VSET 入力インピーダンス			4 8			GΩ pF
V _{SET}	VSET ピン電圧	I _{OUT} = 0.005A～1A の場合		0.01			2 V
k	V _{SET} から I _{OUT} に設定した値のスケール係数	I _{OUT} = V _{SET} / R _{SET} × k		10000			
	I _{OUT} /V _{SET} 帯域幅			800			kHz
R _{SET}	RSET に推奨抵抗			20			kΩ

5.5 低電流モードの電気的特性、MODE=0 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $PVDD = AVDD = 5\text{V}$ 、 $R_{BIAS} = AVDD$ 、 $MODE = 0$ 、 $PD = 0$ 、およびスナバという図 5-31 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
定電流 (I _{CC})、MODE=0、MODE=1 の場合							
I _{CC}	定電流	R _{BIAS} = 25kΩ ～ 500Ω の場合		4		200	mA
	無効	R _{BIAS} を接続します		AVDD			V
	精度	I _{CC} = 100mA				±5.5	%
			T _A = -40°C ～ +125°C			±7.5	
LVDS INPUT							
	LVDS から IOUT への伝搬遅延	I _{OUT} = 1A			10		ns
			T _A = -40°C ～ +125°C		13		
	周波数 (LVDS/TTL/CMOS)				250		MHz
	EP および EN の電圧	V _{CM} ±V _{DIFF} ⁽⁵⁾	f > 10MHz	AGND + 0.5	AVDD - 0.5		V
			DC 負荷および f < 10MHz	AGND	AVDD		
	IOUT ジッタ	f < 250MHz、50% デューティ サイクル			6		ps
電源							
	スタティック静止電流	LVDS = 0、V _{SET} = 0.2V				7	mA
			T _A = -40°C ～ +125°C			8	
	ダイナミック静止電流	Δ LVDS (10MHz の場合)、I _{OUT} = 1A			13		mA
		Δ LVDS (250MHz の場合)、I _{OUT} = 1A			80		mA
サーマル シャットダウン、MODE = 0、MODE = 1 の場合							
T _{SHD}	サーマル シャットダウン温度				160		°C
	サーマル シャットダウン ヒステリシス				10		°C
	ダイ熱時定数	JEDEC PCB に実装されるデバイス			図 5-28 を参照してください		
MODE:MODE = 0、MODE = 1 の場合							
	動作モード	低電流モード、MODE = 0	T _A = -40°C ～ +125°C	AGND + 1.2			V
		高電流モード、MODE = 1	T _A = -40°C ～ +125°C	AVDD - 1.2			
パワーダウン、MODE = 0、MODE = 1 の場合							
I _{PD}	パワーダウン電流		T _A = -40°C ～ +125°C	35			μA
	電圧スレッシュホールド有効化	PD = 0	T _A = -40°C ～ +125°C	AGND + 1.2			V
	電圧スレッシュホールド無効化	PD = 1	T _A = -40°C ～ +125°C	AVDD - 1.2			V
	ターンオン時間の遅延	PD = 1 → 0	T _A = -40°C ～ +125°C	15			μs
	ターンオフ時間の遅延	PD = 0 → 1	T _A = -40°C ～ +125°C	1			μs

- (1) LMH13000 は、上述の制限よりも大きい V_{SET} で動作し続けますが、寿命全体にわたる信頼性は保証されません。
- (2) I_{OUT} の精度を達成するために、 $MINV_{IOUT}$ を維持します。 I_{OUT} の精度が重要でない場合は、熱性能をさらに向上させるため、この仕様をさらに低くします。
- (3) C_{IOUT} は、IOUT ピンから PGND ピンへの静電容量です。
- (4) L_{IOUT} は、IOUT ピンと内部 FET のドレインとの間の直列インダクタンスです。
- (5) 高周波動作の場合のみ、EP と EN に印加される電圧は、どちらのレールからでも 0.5V 以上にとどまります。低周波数動作の場合、EP と EN は、どちらのレールにも最大で対応できます。

5.6 高電流モードの電氣的特性、MODE = 1

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $PVDD = AVDD = 5\text{V}$ 、 $RBIAS = AVDD$ 、 $MODE = 1$ 、 $PD = 0$ 、およびスナバ [図 5-31](#) (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
IOUT DC 性能							
I _{OUT}	可変電流 ⁽⁴⁾	V _{SET} = 0.1V～2V	T _A = −40°C ～ +125°C	0.25		5	A
	I _{OUT} の精度	I _{OUT} = 0.5A				±10.5	%
		I _{OUT} = 2A				±6	
		I _{OUT} = 5A				±4	
	I _{OUT} 変動	I _{OUT} = 0.5A	T _A = −40°C ～ +125°C			±2.5	%
		I _{OUT} = 2A	T _A = −40°C ～ +125°C			±1.3	
		I _{OUT} = 5A	T _A = −40°C ～ +125°C			±0.9	
MINV _{IOUT}	最小 V _{IOUT} ⁽¹⁾	I _{OUT} =0.5A	T _A = −40°C ～ +125°C	0.7			V
		I _{OUT} =5A	T _A = −40°C ～ +125°C	2.2			
I _{LEAK}	I _{OUT} でのリーク電流	PD = 1 または LVDS = 0、				0.35	μA
			T _A = −40°C ～ +125°C			100	
MAXV _{IOUT}	最大 V _{IOUT}					18	V
IOUT の AC 性能 (R _{DAMP} = 1Ω、L _{LOAD} = 1nH)、図 5-31 をご参照してください							
C _{IOUT}	IOUT インピーダンス	並列容量 ⁽²⁾		図 5-12 を参照してください			pF
L _{IOUT}	IOUT インピーダンス	直列インダクタンス ⁽³⁾		100			pH
	I _{OUT} ノイズ	I _{OUT} = 0.5A、 積分帯域幅= 100MHz	T _A = −40°C ～ +125°C	200			μA _{RMS}
t _r	I _{OUT} 立ち上がり時間	I _{OUT} = 2A、VLD = 6V		0.5			ns
			T _A = −40°C ～ +125°C	0.6			
t _f	I _{OUT} 立ち下がり時間	I _{OUT} = 2A、VLD = 6V		0.5			ns
			T _A = −40°C ～ +125°C	0.7			
	I _{OUT} オーバーシュート	I _{OUT} = 2A、VLD = 6V		20			%
	I _{OUT} アンダーシュート	I _{OUT} = 2A、VLD = 6V		15			%
	I _{OUT} セットリング タイム	I _{OUT} = 2A、10%セットリング		4			ns
			T _A = −40°C ～ +125°C	6			
VSET (I _{OUT} 制御ピン)							
V _{SET}	VSET ピンの電圧	I _{OUT} = 0.25A～5A の場合		0.1		2	V
k	V _{SET} から I _{OUT} に設定した値のスケーリング係数	I _{OUT} = V _{SET} / R _{SET} × k		50000			
	I _{OUT} /V _{SET} 帯域幅			600			kHz
LVDS INPUT							
	LVDS から IOUT への伝搬遅延	I _{OUT} = 2A		9			ns
			T _A = −40°C ～ +125°C	13			
		I _{OUT} = 5A		9			
			T _A = −40°C ～ +125°C	10			
	周波数 (LVDS/TTL/CMOS)			250			MHz
	IOUT ジッタ	f < 250 MHz、50% デューティサイクル		7			ps
電源							
	スタティック静止電流	LVDS = 0、V _{SET} = 0.2V		23.5			mA
			T _A = −40°C ～ +125°C	24			
	ダイナミック静止電流	Δ LVDS (10MHz)、I _{OUT} = 5A		50			mA
		Δ LVDS (200MHz)、I _{OUT} = 5A		360			

- (1) I_{OUT} の精度を達成するために、 $MINV_{IOUT}$ を維持します。 I_{OUT} の精度が重要でない場合は、熱性能をさらに向上させるため、この仕様をさらに低くします。
- (2) C_{IOUT} は、IOUT ピンから PGND ピンへの静電容量です。
- (3) L_{IOUT} は、IOUT ピンと内部 FET のドレインとの間の直列インダクタンスです。
- (4) LMH13000 は、記載の制限値を超える V_{SET} で動作しますが、寿命全体にわたる信頼性は保証されません。

5.7 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $AVDD = PVDD = 5\text{V}$, $R_{DAMP} = 1\Omega$, $L_{LOAD} = 1\text{nH}$, $R_{BIAS} = AVDD$ (特に記述のない限り)

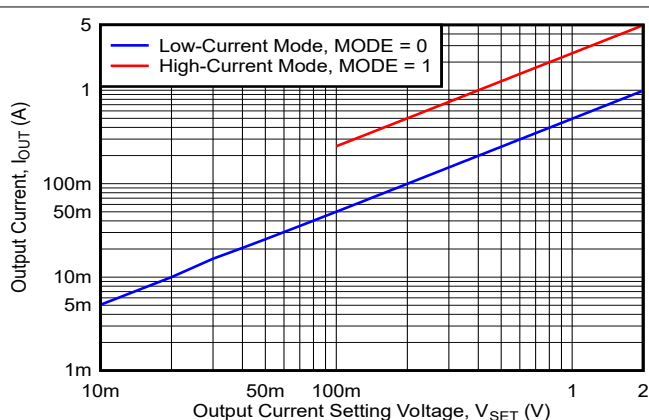


図 5-1. V_{SET} を I_{OUT} に変換する伝達特性

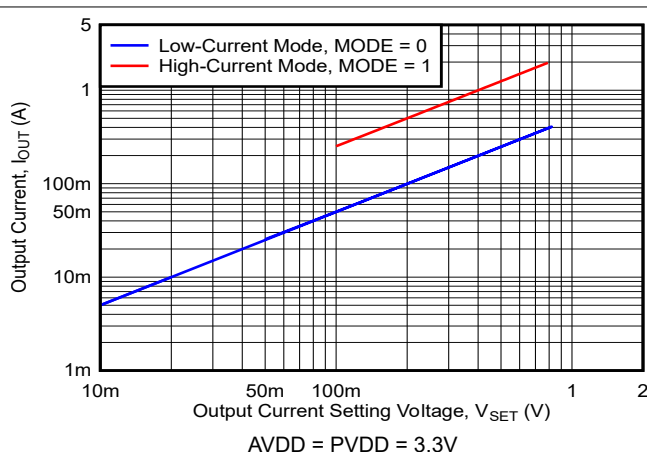


図 5-2. V_{SET} を I_{OUT} に変換する伝達特性

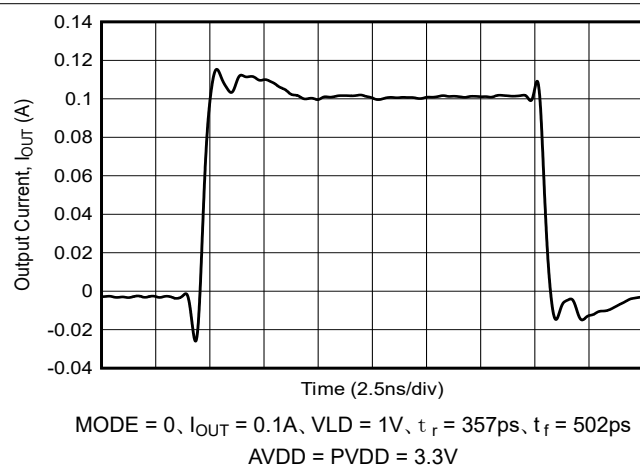


図 5-3. I_{OUT} フェーズ応答

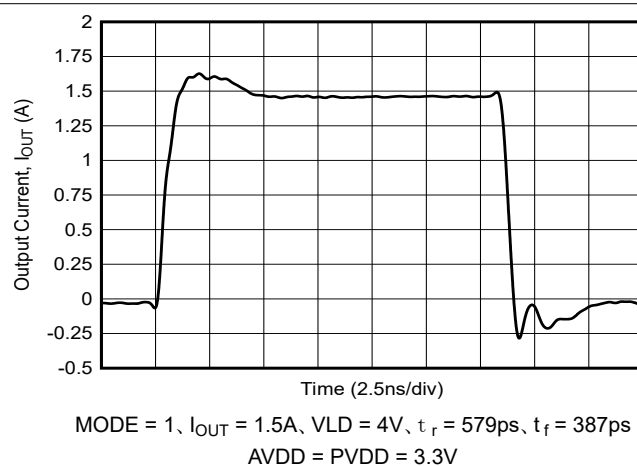


図 5-4. I_{OUT} フェーズ応答

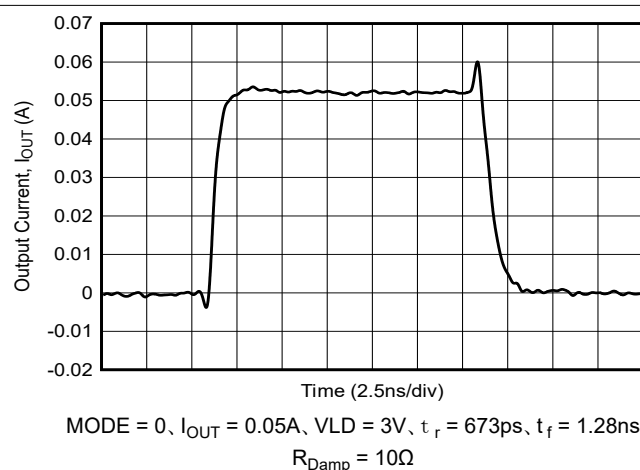


図 5-5. I_{OUT} フェーズ応答

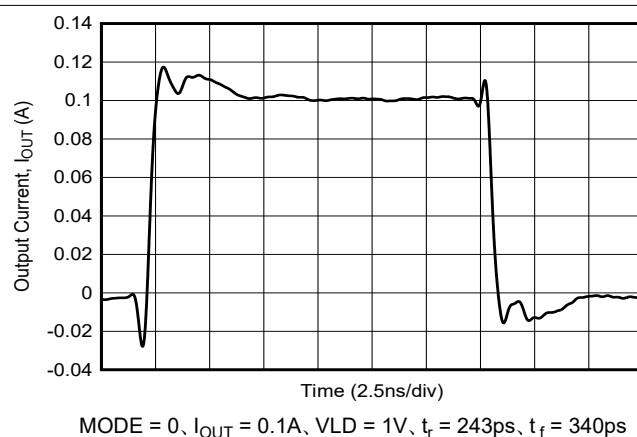


図 5-6. I_{OUT} フェーズ応答

5.7 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $AVDD = PVDD = 5\text{V}$, $R_{DAMP} = 1\Omega$, $L_{LOAD} = 1\text{nH}$, $R_{BIAS} = AVDD$ (特に記述のない限り)

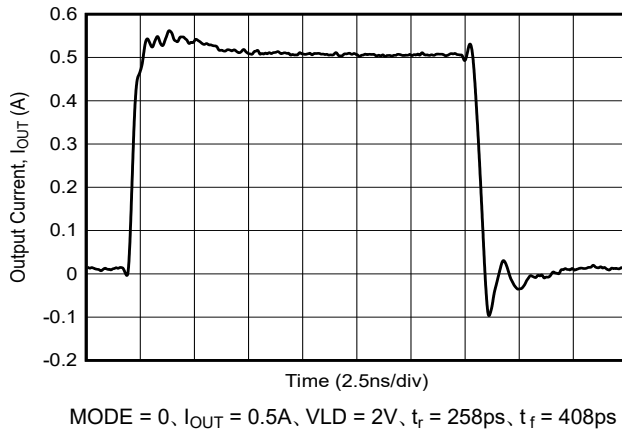


図 5-7. I_{OUT} フェーズ応答

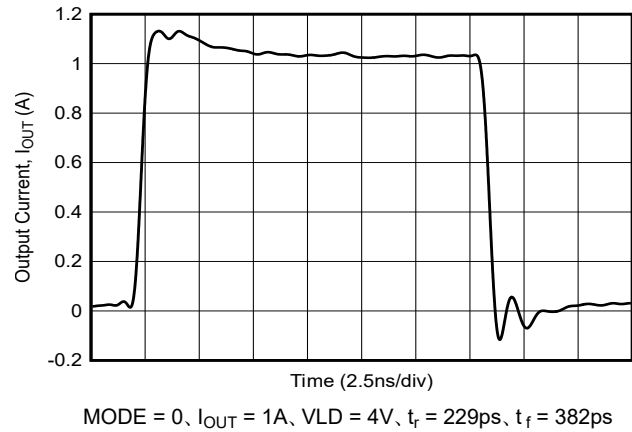


図 5-8. I_{OUT} フェーズ応答

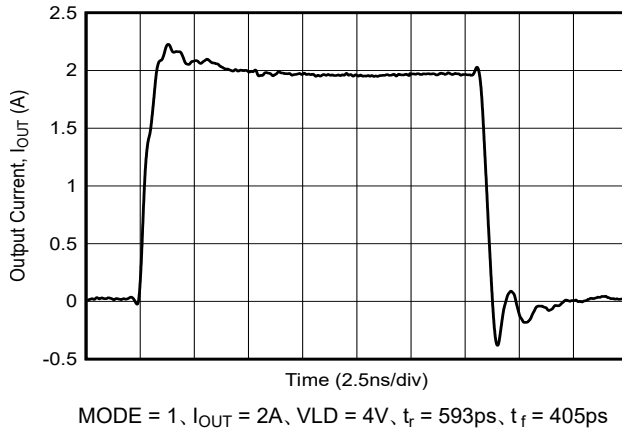


図 5-9. I_{OUT} フェーズ応答

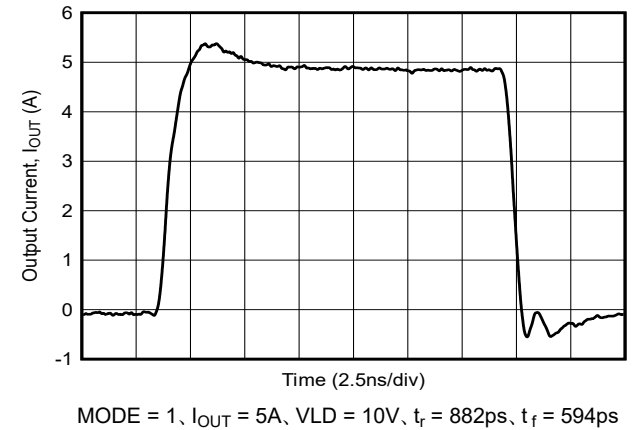


図 5-10. I_{OUT} フェーズ応答

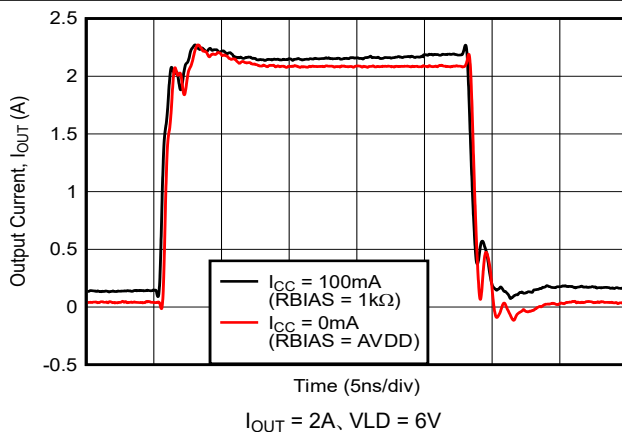
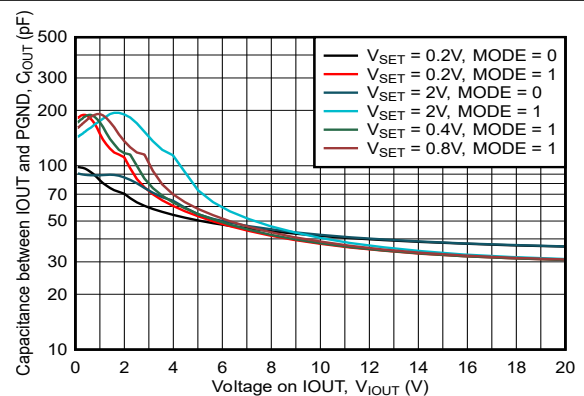


図 5-11. I_{CC} あり/なしでの I_{OUT} パルス応答



I_{OUT} と PGND の間の容量、

図 5-31 参照

図 5-12. C_{IOUT} と V_{IOUT} の関係

5.7 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $AVDD = PVDD = 5\text{V}$, $R_{DAMP} = 1\Omega$, $L_{LOAD} = 1\text{nH}$, $R_{BIAS} = AVDD$ (特に記述のない限り)

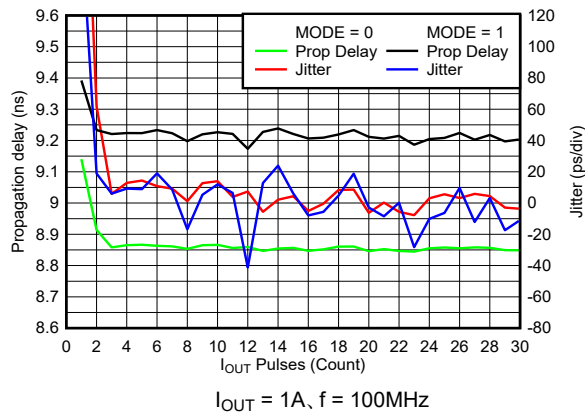


図 5-13. LVDS を I_{OUT} に、タイミング特性

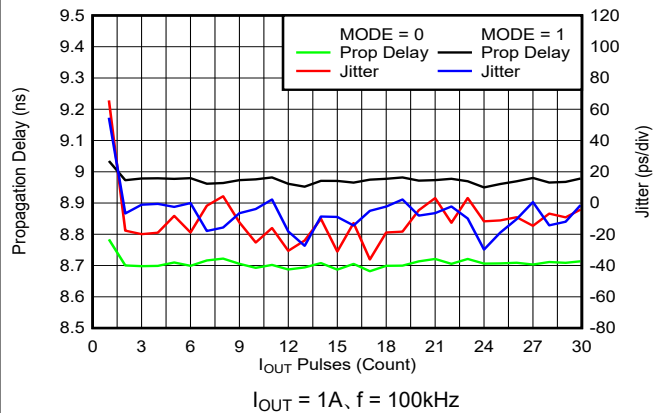


図 5-14. LVDS を I_{OUT} に、タイミング特性

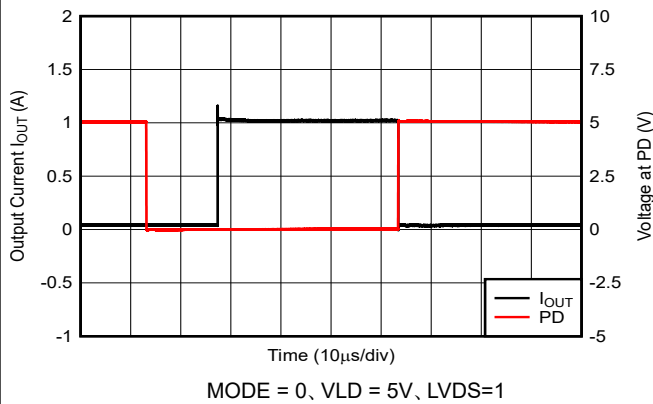


図 5-15. PD と I_{OUT} の応答

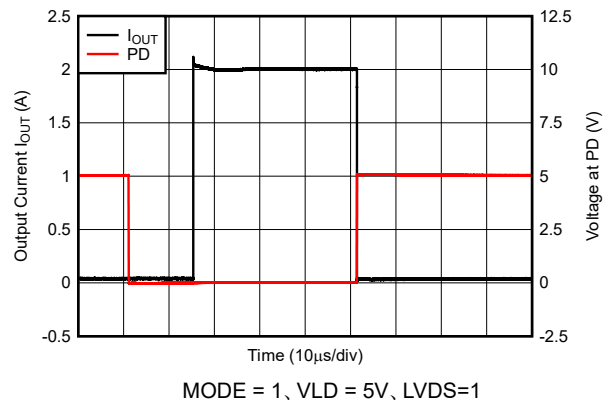


図 5-16. PD と I_{OUT} の応答

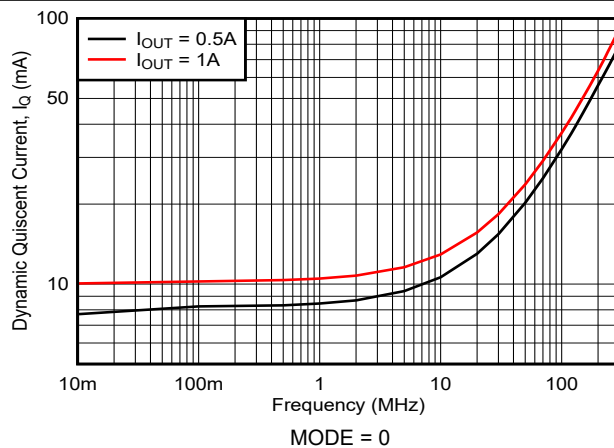


図 5-17. 静止電流と LVDS 周波数との関係

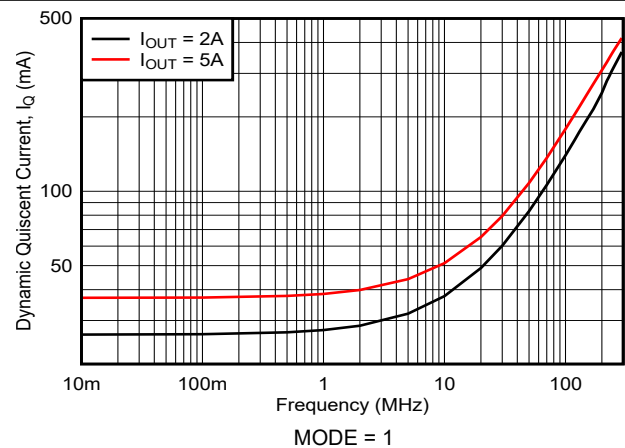


図 5-18. 静止電流と LVDS 周波数との関係

5.7 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $AVDD = PVDD = 5\text{V}$, $R_{DAMP} = 1\Omega$, $L_{LOAD} = 1\text{nH}$, $R_{BIAS} = AVDD$ (特に記述のない限り)

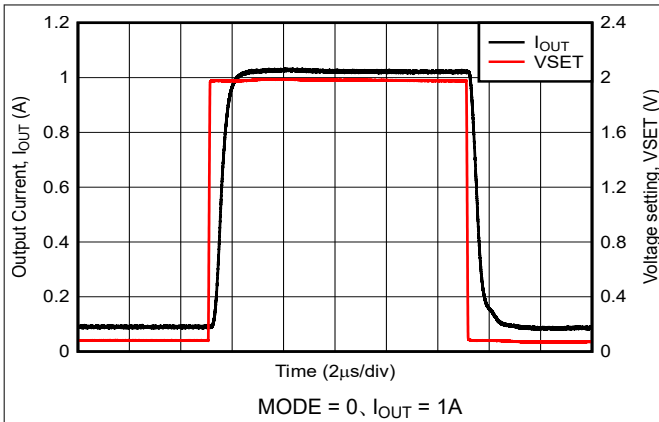


図 5-19. VSET から I_{OUT} へのステップ応答

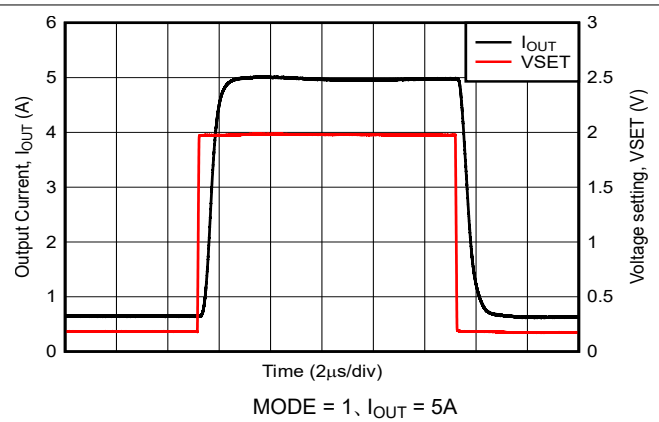


図 5-20. VSET から I_{OUT} へのステップ応答

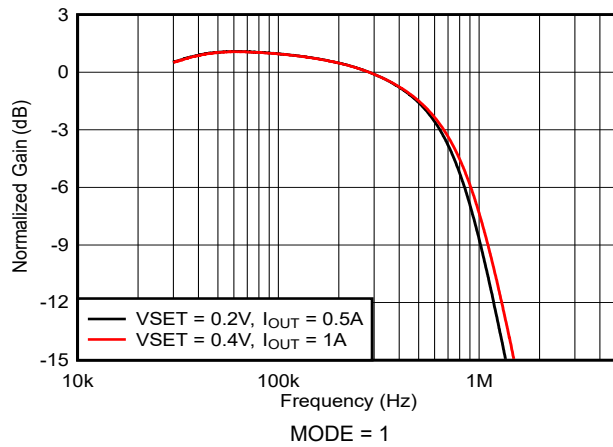


図 5-21. VSET から I_{OUT} への帯域幅の応答

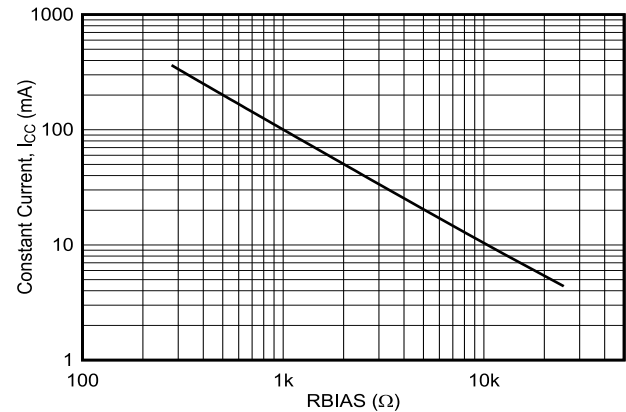


図 5-22. 定電流バイアス伝達関数

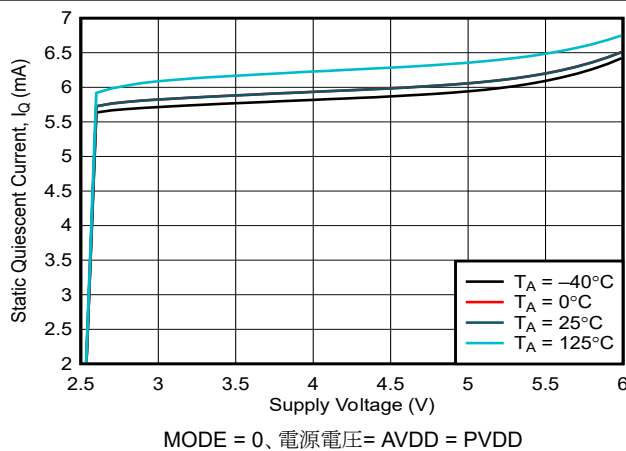


図 5-23. スタティック静止電流と電源電圧との関係

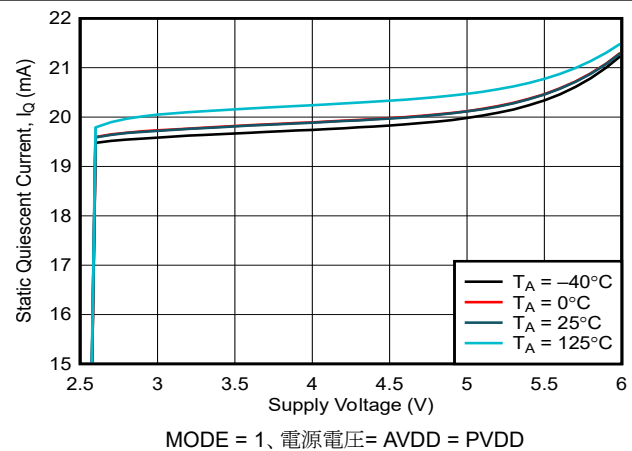


図 5-24. スタティック静止電流と電源電圧との関係

5.7 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $AVDD = PVDD = 5\text{V}$, $R_{\text{DAMP}} = 1\Omega$, $L_{\text{LOAD}} = 1\text{nH}$, $R_{\text{BIAS}} = AVDD$ (特に記述のない限り)

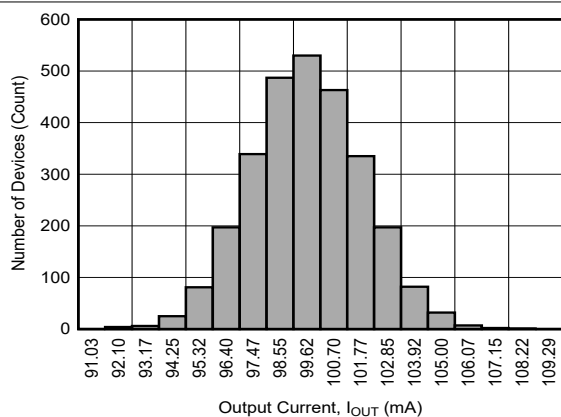


図 5-25. I_{OUT} の精度ヒストグラム

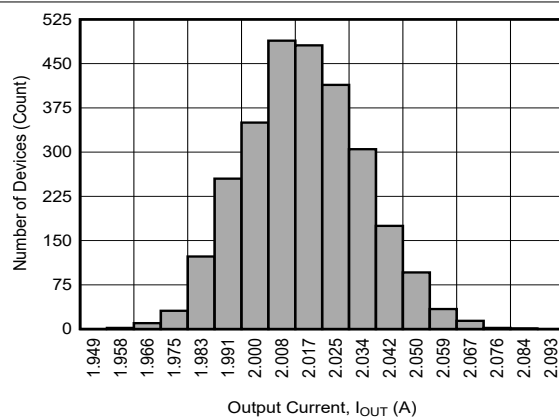


図 5-26. I_{OUT} の精度ヒストグラム

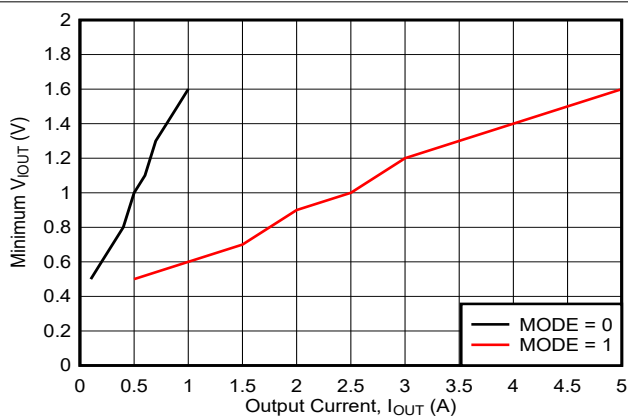
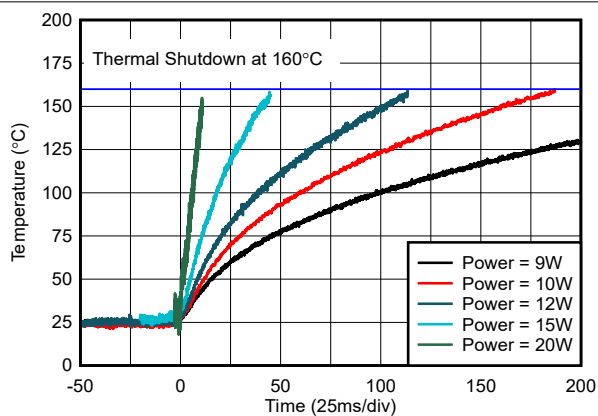
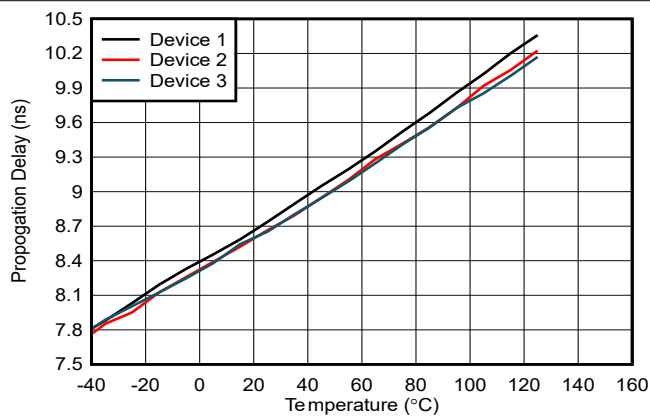


図 5-27. I_{OUT} の最小電圧対出力電流



電力 = $I_{\text{OUT}} \times V_{\text{IOUT}}$ 、デバイスで消費される電力

図 5-28. デバイスのダイ温度と消費電力との関係



LVDS 入力 (V) から I_{OUT} (A) までの信号の伝搬遅延

図 5-29. 伝搬遅延と温度との関係

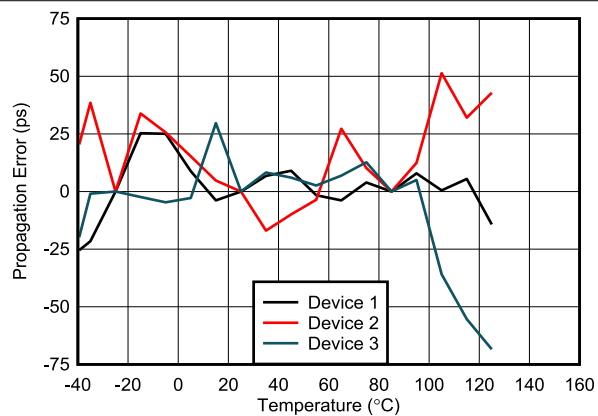


図 5-30. 3 温度キャリブレーション後の伝搬遅延誤差

5.8 パラメータ測定情報

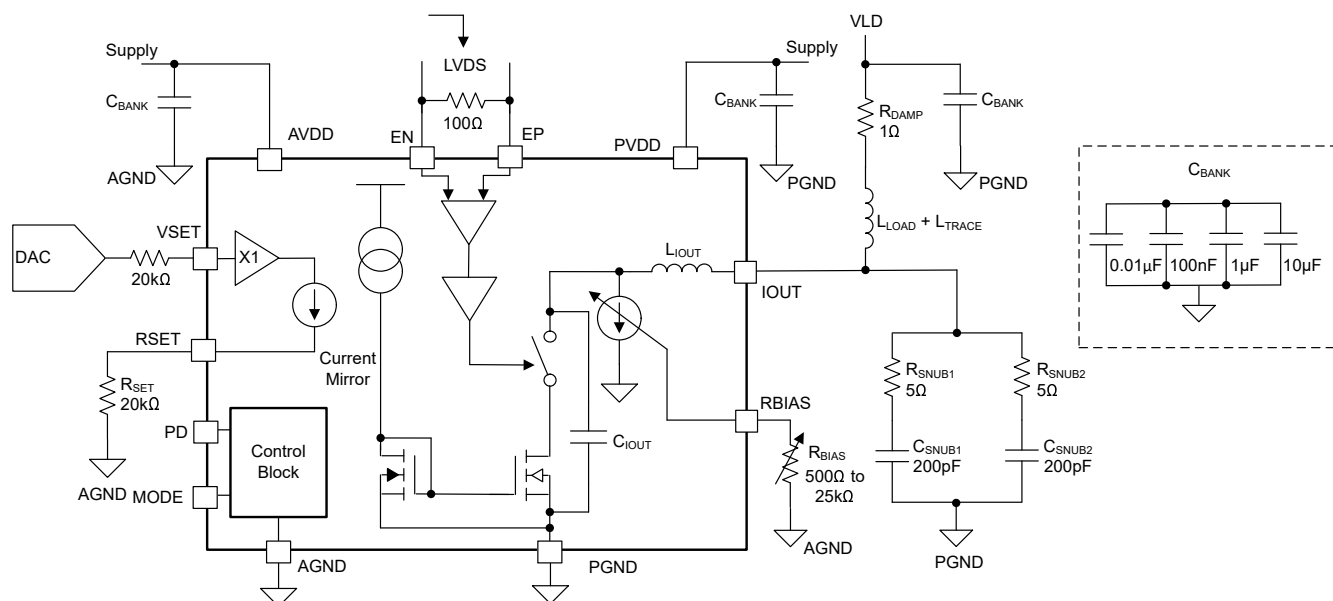


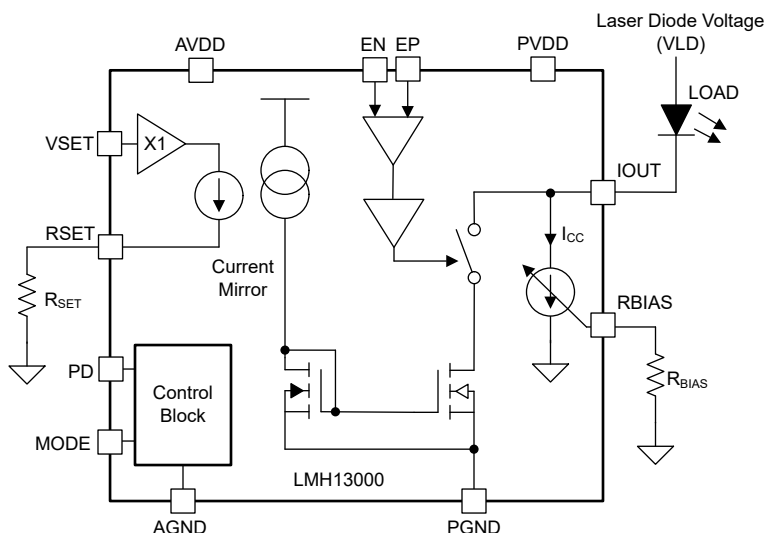
図 5-31. 電気的パラメータ測定回路

6 詳細説明

6.1 概要

LMH13000 は、高速の電圧制御電流源であり、定電流およびパルス電流出力に対応するよう設計されています。このため、このデバイスは、光伝番時間 (ToF) のアプリケーションにおけるレーザー駆動などの用途に最適な選択肢となります。立ち上がり時間および立ち下がり時間が **1ns** の LMH13000 は、産業用光学センサ、光時間領域反射測定 (OTDR)、高速電流負荷、および体外診断 (IVD) やフロー サイトメリーなどの医療用途向けに設計されています。このデバイスは、最大 **1A** の連続電流および最大 **5A** のパルス電流をサポートしています。LMH13000 は、**3V ~ 5.5V** のバイアス電圧範囲で動作し、**IOUT** は最大 **18V** の電圧をサポートしています。LVDS 入力は出力電流の時間制御を可能にします。一方 VSET 入力は出力電流の振幅制御を可能にします。これらの特長により、LMH13000 は、高速、高精度の電流駆動アプリケーションにおいて、信頼性が高く効率的なソリューションとなります。

6.2 機能ブロック図



6.3 機能説明

6.3.1 定電流 (I_{CC})

LMH13000 は、 I_{OUT} に対して並列の定電流 (I_{CC}) を供給するように設計されています。この定電流は、 V_{SET} で設定される電流に加えて供給されます。 I_{CC} は、適切な R_{BIAS} 抵抗を選択することで調整されます。

$$I_{CC} = \frac{100}{R_{BIAS}} \quad (1)$$

I_{CC} は 4mA から 200mA に設定可能、 $I_{OUT(TOTAL)} = I_{CC}$ 、 $LVDS = 0$ and $PD = 0$ の場合。

次に例を示します。

- $R_{BIAS} = 25k\Omega$ の場合、 $I_{CC} = 4mA$
- $R_{BIAS} = 500\Omega$ の場合、 $I_{CC} = 200mA$

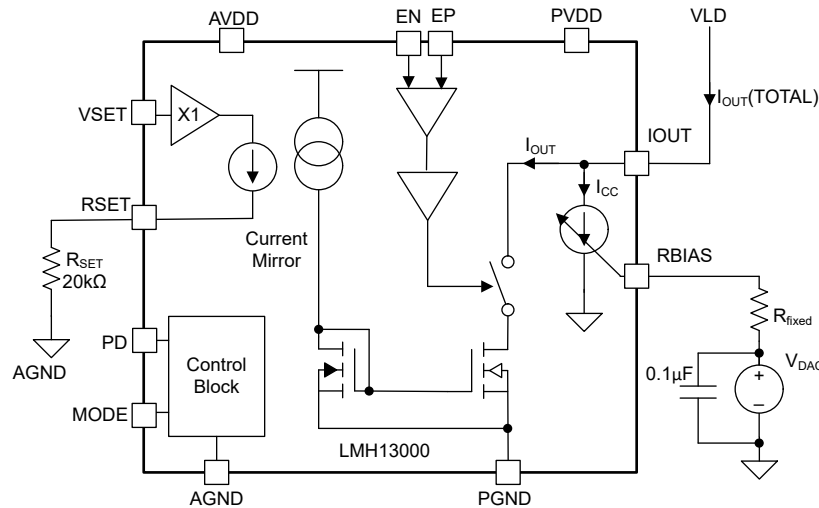


図 6-1. 動的 I_{CC} 制御回路

図 6-1 は、出力電流 $I_{OUT(TOTAL)}$ が I_{CC} (R_{BIAS} で設定) と I_{OUT} の合計であり、これは V_{SET} に依存します。

$$I_{OUT(TOTAL)} = I_{CC} + I_{OUT} \quad (2)$$

R_{BIAS} ピンを $AVDD$ に短絡して、 I_{CC} を無効化します。 I_{CC} は $LVDS$ 入力には依存しません。ただし、 $PD = 1$ (電源オフ状態) の間は、 R_{BIAS} 値に関係なく、 I_{CC} は内部でオフになります。 I_{CC} により、アプリケーションは接続された負荷に流れる電流を一定に保つことができます。レーザー ダイオード駆動などのアプリケーションでは、 I_{CC} のような小さいバイアス電流を使用することで、光学ターンオン時間を向上できます。

図 6-1 は、 R_{fixed} 抵抗のもう一方の端に DAC を接続することにより、 I_{CC} を動的に変更する方法を示します。

式 3 は、特定の R_{fixed} 抵抗を R_{BIAS} ピンに接続したときの I_{CC} と V_{DAC} の関係を示します。

$$I_{CC} = 200 \times \left(\frac{0.5 - V_{DAC}}{R_{fixed}} \right) \quad (3)$$

6.3.2 伝搬遅延と温度との関係

6.3.2.1 温度による伝搬遅延のキャリブレーション

ToF 計算の開始基準点として LMH13000 への LVDS 入力を利用するシステムでは、LVDS から IOUT までの比例遅延を正確にキャリブレーションする必要があります。デバイスの動作の変化により、伝搬遅延は温度によって変化するため、影響を受けやすいシステムでタイミングの不一致が発生します。

測定とキャリブレーションのアプローチ:

1. 低温 (-40°C)、周囲温度 (25°C)、高温 (125°C) の 3 つの主要な温度ポイントで伝搬遅延値を測定します。
2. 線形回帰法を用いて遅延対温度曲線に二次多項式フィットを適用した。
3. この多項式を使用して、中間温度での遅延値を予測します。
4. 遅延推定の誤差については、[図 5-30](#) を参照してください。グラフは、実際の測定遅延と予測遅延の差を示しています。

このキャリブレーション技術により、温度に起因する伝搬遅延シフトを効果的に補償できます。多項式補正を適用することにより、複数の動作条件にわたって一貫したタイミング挙動が維持されます。

6.3.2.2 IOUT から直接パルスを開始します

さらに高い精度が必要なアプリケーションや、温度範囲全体にわたって較正できないアプリケーションでは、以下の回路手法により、レーザー段を直接監視して、高精度のスタートパルス生成できます。レーザー電流パルスにより、ToF 測定用のスタート信号が生成されます。レーザーと直列に接続された抵抗 R_{DAMP} が電流検出素子として機能します。抵抗の両端の電圧降下は差動に変換され、次のようにパルス開始信号を提供します。

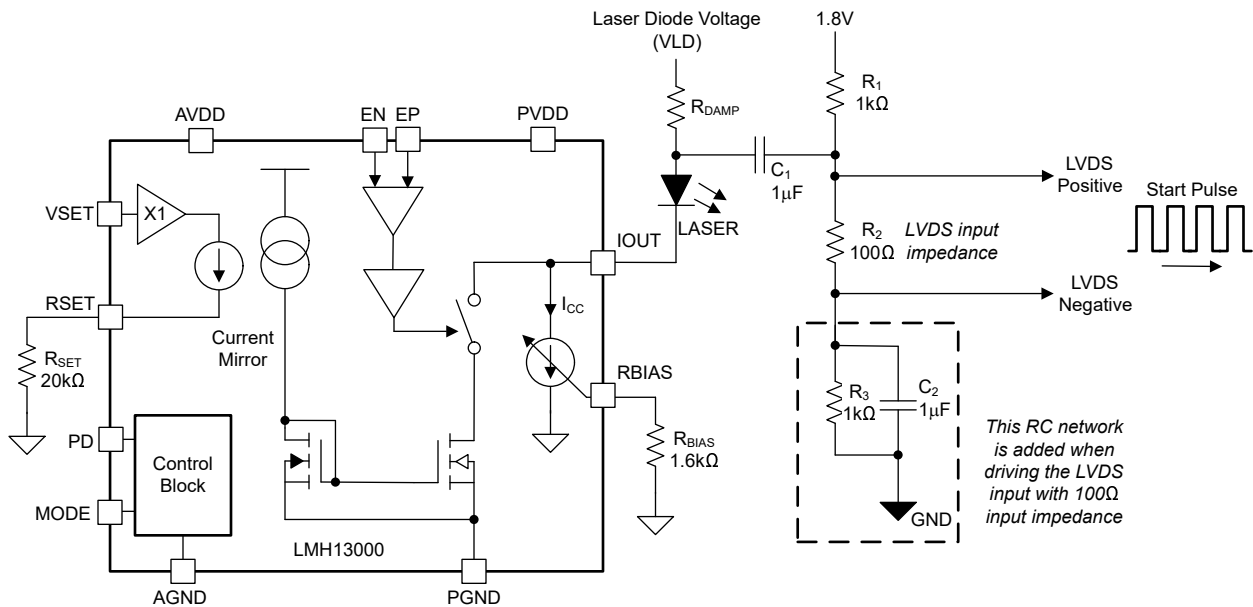


図 6-2. タイムオブフライト測定用のレーザー ダイオード パルス生成

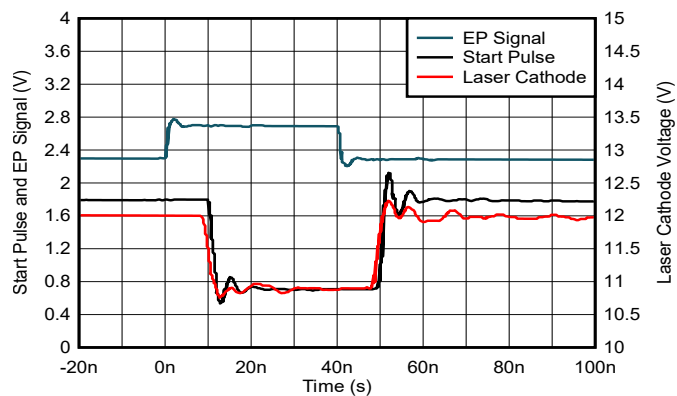


図 6-3. スタートパルス、EP 信号、レーザー カソード電圧と時間との関係

この方法により、LMH13000 レーザー ドライバの伝搬遅延キャリブレーションは不要になります。同じ構成で、入力インピーダンスが 100Ω の LVDS ドライバと他の高入力インピーダンス I/O ドライバの両方も駆動されます。

6.4 デバイスの機能モード

LMH13000 は、2 つの動作モードと 1 つのパワー ダウン モードの、合計 3 つのモードで動作します。

- 通常動作モード (PD = 0) :
 - 低電流モード (MODE = 0)
 - 高電流モード (MODE = 1)
- パワーダウン モードを使用可能 (PD = 1)

通常動作モードでは、PD = 0 の場合、MODE は 0 または 1 です。LVDS = 0 または 1 に基づき、IOUT は電流フローを許可またはブロックします。

- 低電流モード (MODE = 0) の場合:

$$I_{OUT} = \frac{V_{SET}}{R_{SET}} \times k; k = 10000 \quad (4)$$

- V_{SET} は 0.01 ~ 2V の範囲であるため、 I_{OUT} は 5mA ~ 1A になります。
- 低電流モードにより、静止動作電流を低減できます。
- IOUT に必要なヘッドルームは、高電流モードに比べて比較的高くなります。
- 同じレーザー ダイオード バイアス (VLD) でバイアスすると、低電流モードでは、高電流モードに比べてオーバーシュートが小さくなります。

- 高電流モード時 (MODE = 1)

$$I_{OUT} = \frac{V_{SET}}{R_{SET}} \times k; k = 50000 \quad (5)$$

- V_{SET} は 0.1 ~ 2V の範囲であり、 I_{OUT} は 250mA ~ 5A に設定されます。
- 高電流モードは、比較的高い静止動作電流を消費します。
- IOUT に必要なヘッドルームは、低電流モードに比べて比較的低くなっています。
- 低電流モードと比較して、同じ VLD でバイアスすると、大きなオーバーシュートが観測されます。

パワーダウンモード (PD = 1) では、出力は実質的にディセーブルされ、デバイスは非常に低い静止電流で動作し、IOUT で観測されるリークは最小限です。

表 6-1. 真理値表

PD	モード	LVDS ⁽¹⁾	I _{OUT} ⁽²⁾	I _{CC} ⁽³⁾
0	0	LVDS = 1	$V_{SET} / R_{SET} \times 10k$	$100 / R_{BIAS}$
0	1	LVDS = 1	$V_{SET} / R_{SET} \times 50k$	$100 / R_{BIAS}$
0	X ⁽³⁾	LVDS = 0	I _{LEAK}	$100 / R_{BIAS}$
1	X	X	I _{LEAK}	0A

(1) a. LVDS = 0、EP - EN < -100mV

b. LVDS = 1、EP-EN > 100mV

(2) I_{OUT}(TOTAL) = I_{OUT} + I_{CC}

(3) R_{BIAS} と AGND の間に接続された抵抗があると仮定します。R_{BIAS} = AVDD なら、I_{CC} = 0A です。

(4) X = 未使用。

7 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する部品の最適な選択肢については、TI のお客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システム機能の動作確認が必須になります。

7.1 アプリケーション情報

LMH13000 は、汎用電流出力ドライバです。LMH13000 は、定電流またはパルス電流駆動を必要とするあらゆる負荷の駆動に使用されます。

7.2 代表的なアプリケーション

7.2.1 光飛行時間システム

光飛行時間 (ToF) システムは、直接と間接の二種類のアプローチで構成されています。LMH13000 は、光が光源から物体まで往復する際の時間遅延と位相遅延を測定する両方のアプローチをサポートしているため、物体までの距離の測定に役立ちます。

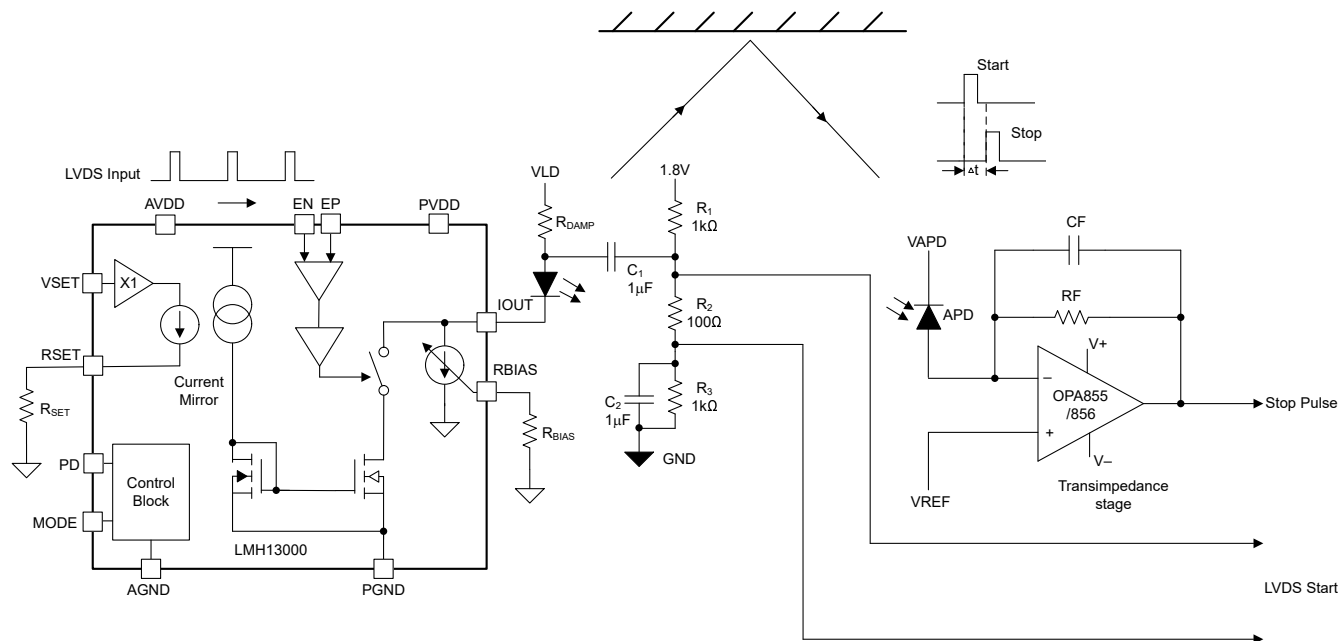


図 7-1. LMH13000 を使用した送信経路における光飛行時間 (ToF)

7.2.1.1 設計要件

表 7-1. 設計パラメータ

パラメータ	値
狭い光学パルスを生成	2ns
光の立ち上がり時間	<1ns
電力出力	2A
瞬間光出力	1.5W
光出力安定性	全温度範囲に対し 2% 未満

表 7-2. 受信側 TIA 用の推奨デバイス

デバイス	入力タイプ	最小安定ゲイン (V/V)	電圧ノイズ (nV/√Hz)	入力容量 (pF)	ゲイン帯域幅 (GHz)
OPA855	バイポーラ	7	0.98	0.8	8
OPA856	バイポーラ	1	0.9	1.1	1.1
OPA858	CMOS	7	2.5	0.8	5.5
OPA859	CMOS	1	3.3	0.8	0.9
LMH6629	バイポーラ	10	0.69	5.7	4

7.2.1.2 詳細な設計手順

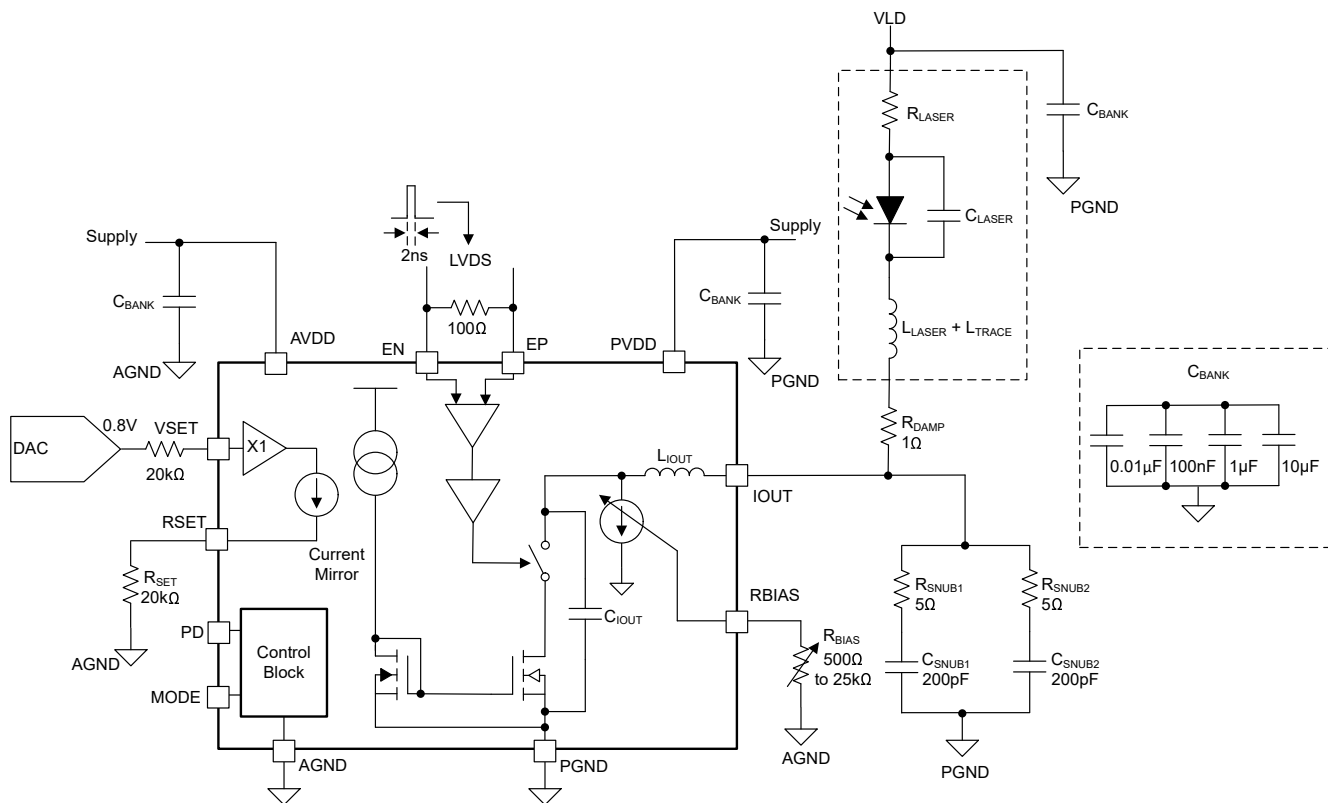


図 7-2. LMH13000 を使用した送信パスの回路図

必要な光出力と立ち上がり時間に基づいて、V105Q121A-940 は送信経路のレーザーと見なされます。LMH13000 の IOUT は、デバイスがシンク電流ドライバであるため、レーザーのカソードに接続されます。レーザーのアノードはバイアス電圧 VLD に接続されています。必要な光出力は 1.5W です。レーザー ダイオードのデータシートの光出力電力グラフを

使用して、 I_{OUT} は 2A として計算されます。2A I_{OUT} が高電流モードでサポートされているため、MODE ピンは AVDD に接続されます。PD ピンは AGND に接続されています。

VSET を 0.8V に設定すると、次の式を使用して I_{OUT} を 2A に設定できます。VSET 電圧は、20k Ω の直列抵抗を介して DAC によって供給されます。

$$I_{OUT} = \frac{V_{SET}}{R_{SET}} \times k; k = 50k \quad (6)$$

必要な VLD 電圧は、 V_{IOUT} 、 V_F 、 I_{OUT} 経路のインダクタンスに必要な最小値の関数です。最小 V_{IOUT} は、「電気的特性」表を使用して推定されます。

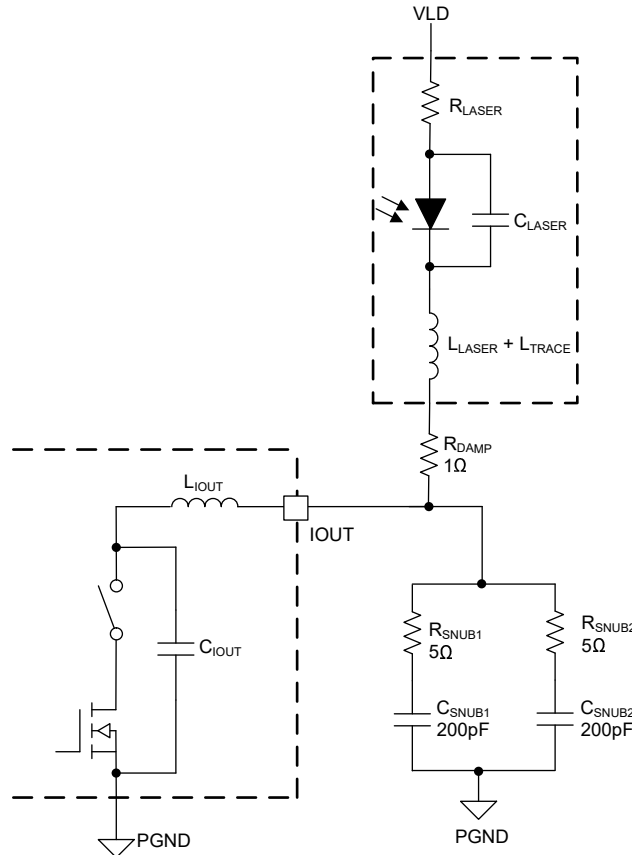
$$VLD = MINV_{IOUT} + V_F + L \times \frac{dI_{OUT}}{dt} + I_{OUT} \times (R_{LASER} + R_{DAMP}) \quad (7)$$

ここで、 V_F はレーザー ダイオードの順方向バイアス電圧、 $L = L_{LASER} + L_{TRACE}$ 、 $dI_{OUT} = 2A$ 、 $dt = 1ns$ です。

特定の I_{OUT} に必要な $MINV_{IOUT}$ については、[図 5-27](#) を参照してください。[図 5-27](#) に従って、 $MINV_{IOUT}$ は、 I_{OUT} が 2A の場合、約 1V と算出されます。2A パルスの場合、 $V_F = 1.85V$ (レーザーのデータシートから)。レーザーと基板配線のインダクタンスの合計であるインダクタンス L は、約 1.5nH と推定され、測定されます。これらの値を加算すると、必要な最小 VLD は約 6V となります ($R_{DAMP} = 0\Omega$ と仮定)。直流、低速立ち上がり時間、電流出力アプリケーションでは、前の式で $L \times dI_{OUT}/dt$ 成分を 0 にできます。

2ns のパルス幅を実現するには、2ns の持続期間を備える 250mV 以上の LVDS 信号が LVDS ピン間に適用されます。LVDS の同相電圧と差動電圧が、「電気的特性」に規定された最大制限内に十分に収まるように設計します。

この設定は、オンタイムが 2ns の 2A の電流パルスを生成するための初期ガイドラインを提供します。異なる周波数とデューティサイクルのパルス列を実現するには、必要なロジック信号 (LVDS/CMOS/TTL) を EP ピンと EN ピンに印加するだけです。

図 7-3. I_{OUT} バス用の二次 RLC 回路

電気領域または光学的領域の I_{OUT} パルス応答を観察すると、必要な電流出力応答を達成するために回路を調整するための一般的な方向が示されます。

- VLD 電圧の増加により、立ち上がり時間が短いほど、基板およびレーザーのインダクタンスにわたる電流を設定するために利用可能な電圧が高くなります。ただし、VLD が高くなると、オーバーシュートはそれに比例して増加します。
- I_{OUT} パルスにおける重要な応答を実現するために、図 7-3 に示す二次系で ZETA (ζ) を 1 にすることを設計の目標とします。C_{IOUT} よりはるかに大きな C_{SNUB} を追加することで、二次回路の動作は主に C_{SNUB} の値により決定されます。

$$C_{SNUB} = 5 \times C_{IOUT} \quad (8)$$

最小 V_{IOUT} の C_{IOUT} については、図 5-12 を参照してください。

- C_{SNUB} は、約 300pF と計算され、V_{IOUT} が 6V のとき、C_{IOUT} は、約 62pF となります。
- 以下の式に C_{SNUB}、L_{LASER+TRACE}、R_{LASER} の値を代入します。

$$\zeta = \frac{R_{LASER} + R_{DAMP} + R_{SNUB}}{2} \times \sqrt{\frac{C_{SNUB}}{L_{LASER} + L_{TRACE}}} \quad (9)$$

立ち上がり時間とオーバーシュートのバランスを適切に保つために、R_{SNUB} を微調整します。スナバを最も効果的にするために、I_{OUT} の両側にスナバを追加します (図 7-6 および 図 7-7 を参照)。

- オーバーシュートと立ち上がり時間のバランスが適切でない場合は、小さな直列ダンピング抵抗 R_{DAMP} を追加することで、オーバーシュート電流出力応答が低減されます。減衰直列抵抗を追加すると、ζ は 1 に近づくか、それを超え、RLC 回路を臨界減衰応答で ∞ 方向へ調整します。

「電气的特性」表には、MODE = 1 で 2A の出力電流に対する室温での精度は約 5% であると記載されています。したがって、2A に設定すると、I_{OUT} は正確に 2A でない可能性があり、実際には 2A ± 5% に設定されています。この不正確

さにより、 V_{SET} を 0.8V より少し大きくまたは小さく調整し、 I_{OUT} を正確に 2A にします。この調整後、[セクション 5.6](#) の温度による I_{OUT} の変動に示されるように、 I_{OUT} は温度に対し $2A \pm 1.3\%$ で精度となります。

出力パルスが I_{OUT} のセtring タイムより短い場合、ピーク振幅は主にオーバーシュート値によって設定されます。このような場合は、ピークオーバーシュート値に合わせて V_{SET} を調整します。

7.2.1.3 アプリケーション曲線

光パルス応答は、Tx パスで OSRAM レーザーを駆動する LMH13000 を使用してキャプチャされ、Rx パス上の APD+TIA を使用してキャプチャされます。TIA 出力は、2ns のパルス幅の生成とキャプチャを示すようにプロットされています。

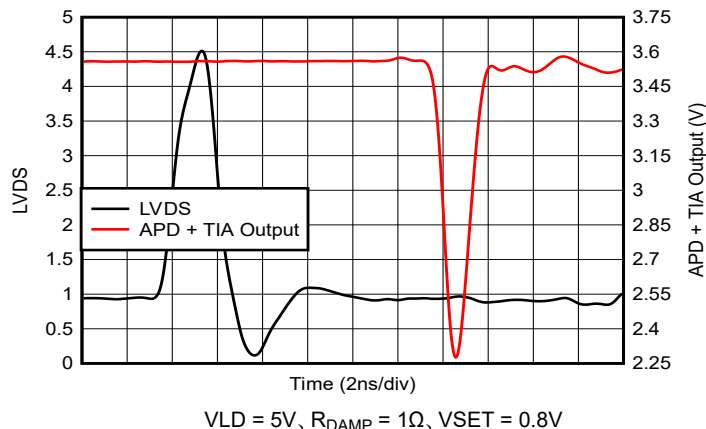


図 7-4. Tx に LMH13000、Rx に APD+TIA での、光応答

7.2.2 LMH13000 を使用した自動電力制御ループ

レーザー駆動システムで安定した光出力を得るために、APC ループは一定の性能を維持します。温度の変動、経年変化、外部条件によりレーザーの動作に変化が生じます。APC ループは、光フィードバックを使用してレーザーを流れる電流を動的に調整し、光出力を固定します。

以下の回路図は、レーザー バックファセット フォトダイオードを使用して、dc およびパルス レーザーの両方の動作をサポートしています。

マルチプレクサが high モードで動作すると APC ループが閉じ、レーザー LD からの光出力が調整され、PD で拾う電流が R_S 抵抗両端の V_{Sense} 電圧に等しい電圧に変換されるようになります。TLV9001 のエラーアンプに印加される V_{REF} 電圧を調整すると、光出力が直接制御されます。マルチプレクサが低モードで動作している場合、前の APC 閉ループモードで設定された電圧が C1 の両端に保存されます。この電圧は LMH13000 の V_{SET} を駆動し、 I_{OUT} を適切なレベルに固定して、必要な光出力を供給します。ユーザーは、外部条件に起因する光出力の変動を定期的に補正するために、low モードと high モードを切り替えます。

詳細については、『[LMH13000 を使用したレーザー ダイオードの自動電力制御](#)』を参照してください

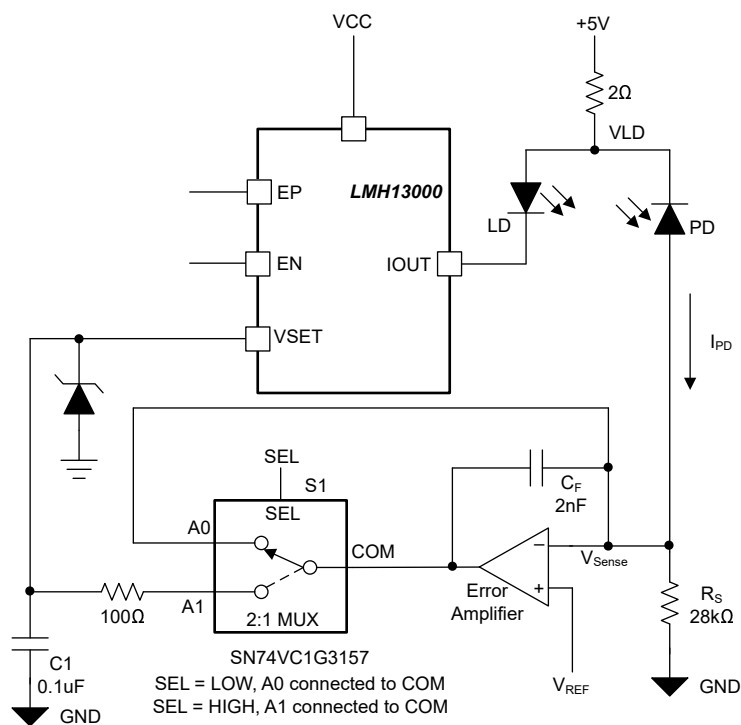


図 7-5. LMH13000 をパルス動作で使用した自動電力制御ループ

7.3 電源に関する推奨事項

AVDD と PVDD は LMH13000 の二つの電源ピンです。AVDD と PVDD を同じ電位に接続します。各ピンに個別のデカップリング コンデンサを配置します。

LMH13000 のパワーアップ中は、AVDD と PVDD の両方がともにシーケンス化されます(上昇)。デカップリング コンデンサの違いに起因する、パワーアップのタイミングの小さなミスマッチは許容されます。すべての条件において、MODE ピンの電圧が AVDD および PVDD より低いことを確認します。この条件を満たすには、MODE ピンを常に AVDD または AGND に接続します。AVDD および PVDD の電源投入後、他のピンには任意のシーケンスで電力を供給できます。

IOUT の電圧を最大 18V に制限します。この制限には、出力電流パルスの立ち下がり時間中に発生するオーバーシュートが含まれます。VLD の電源投入シーケンスは重要ではありませんが、TI は AVDD および PVDD の電源投入後に VLD を投入することを推奨しています。

7.4 レイアウト

7.4.1 レイアウトのガイドライン

出力電流でナノ秒の立ち上がり時間をナノ秒にするには、次の推奨事項を使用します。直流用途や過渡応答性能の緩和を必要とするアプリケーションでは、レイアウトのガイドラインが多少逸脱する可能性があります。

- R_{SNUB} および C_{SNUB} の配置:
 - R_{SNUB} および C_{SNUB} をデバイスのできるだけ近くに配置します。
 - スナバ回路内の寄生直列インダクタンスはすべて、スナバの効果が低下します。効果を高めるために、低インダクタンスの部品を使用してください。
 - IOUT ピンと PGND ピンの両側に 2 つのスナバ回路を追加します(図 7-4 を参照)。
- コンデンサバンクの配置:
 - VLD および PVDD 電源ピンに高速な過渡電流を供給するには、コンデンサバンクが必要です。
 - コンデンサバンクを VLD および PVDD ピンのできるだけ近くに配置します。
 - コンデンサバンクは通常、ピンに最も近い最初のコンデンサとして低 ESL コンデンサで構成されています。
- PVDD と AVDD の接続:
 - PVDD と AVDD はスター型接続する必要があります。直列フェライトビーズを追加し、細いトレースを使って 2 つのピンの高周波ノイズと干渉を最小限に抑えます。両方の電源が同じ電位にある必要があります。
 - 十分な過渡電流を供給するために、各電源に専用のデカップリングコンデンサを配置する必要があります。
- LVDS ピンの EP と EN の配線:
 - EP と EN は差動形式で配線し、100Ω の抵抗で終端します。差動配線は、シグナル・インテグリティの向上と EMI (電磁干渉) の低減に貢献します。
- IOUT トレース設計:
 - C_{BANK} 、VLD、LOAD、 I_{OUT} 、および PGND は、トレース・インダクタンスの影響を低減するために厳密なループを形成する必要があります。
 - 高電流を処理し、配線のインダクタンスを効果的に小さくするには、 I_{OUT} トレースに厚い銅箔ベタを使用する必要があります。
 - ループを最小化できない場合は、VLD C_{BANK} の to および return 部分をまたいで配線します。PCB の最上層と 2 番目の層を使用してこの配線は、電流を反対方向に流すことで達成されています。このレイアウト技術により、共通ソース・インダクタンスを低減できます(図 7-7 こちらも参照)。
- 放熱性能
 - I_{OUT} および PGND ピンの下にサーマルビアを配置し、熱を効率的に放散します。
 - PCB の最下層のサーマルプレーンが優れたヒートシンクとして機能しますが、プレーンまたはヒートシンクを追加すると IOUT の容量が増加します。この容量が大きくなると、 I_{OUT} パルスのオーバーシュートが増加します。
 - オーバーシュートが望ましくない場合は、スナバを適切に調整するか、直列減衰抵抗、 R_{DAMP} を増やしてください。

7.4.2 レイアウト例

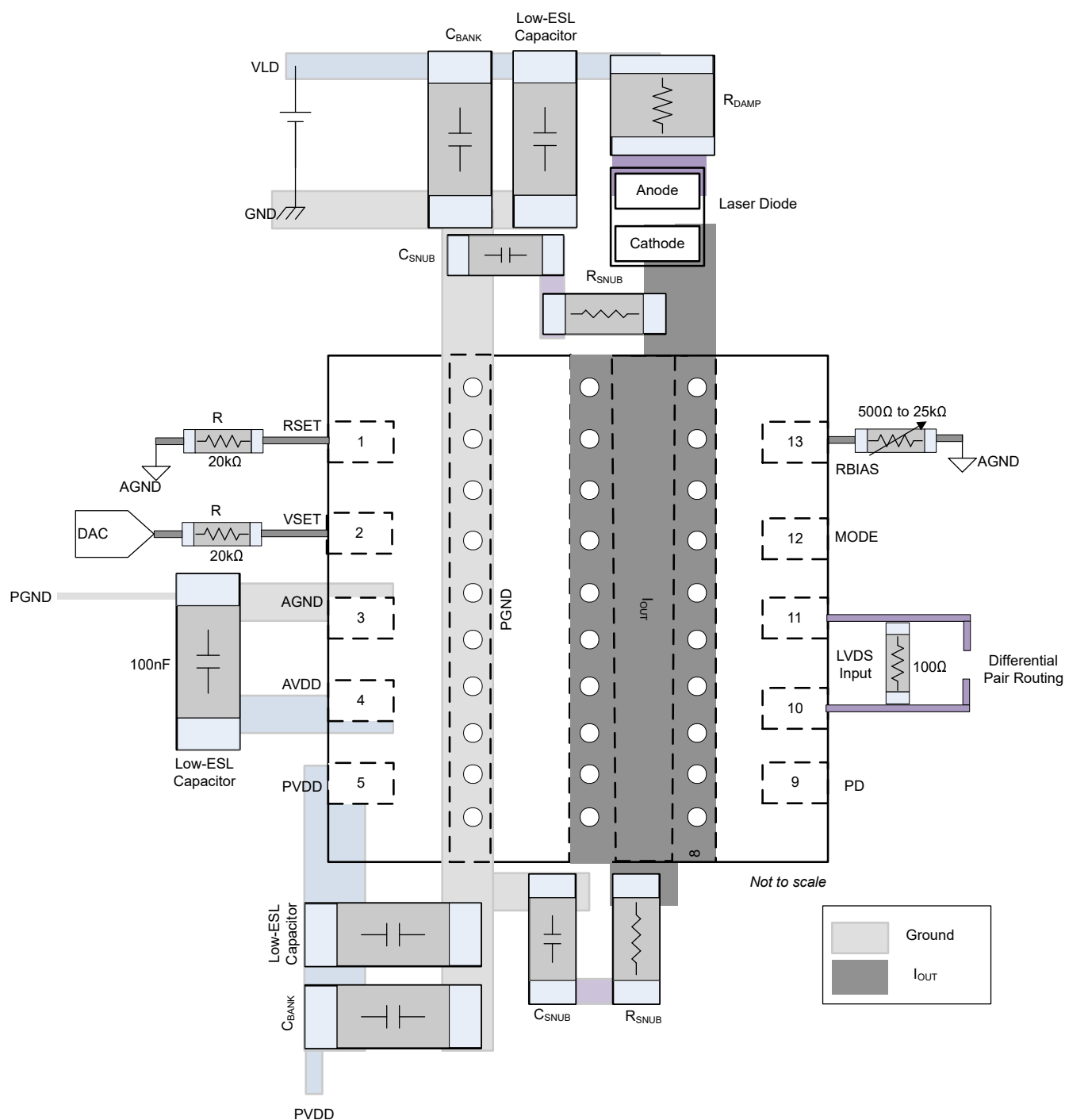


図 7-6. レイアウト例—SMD パッケージ

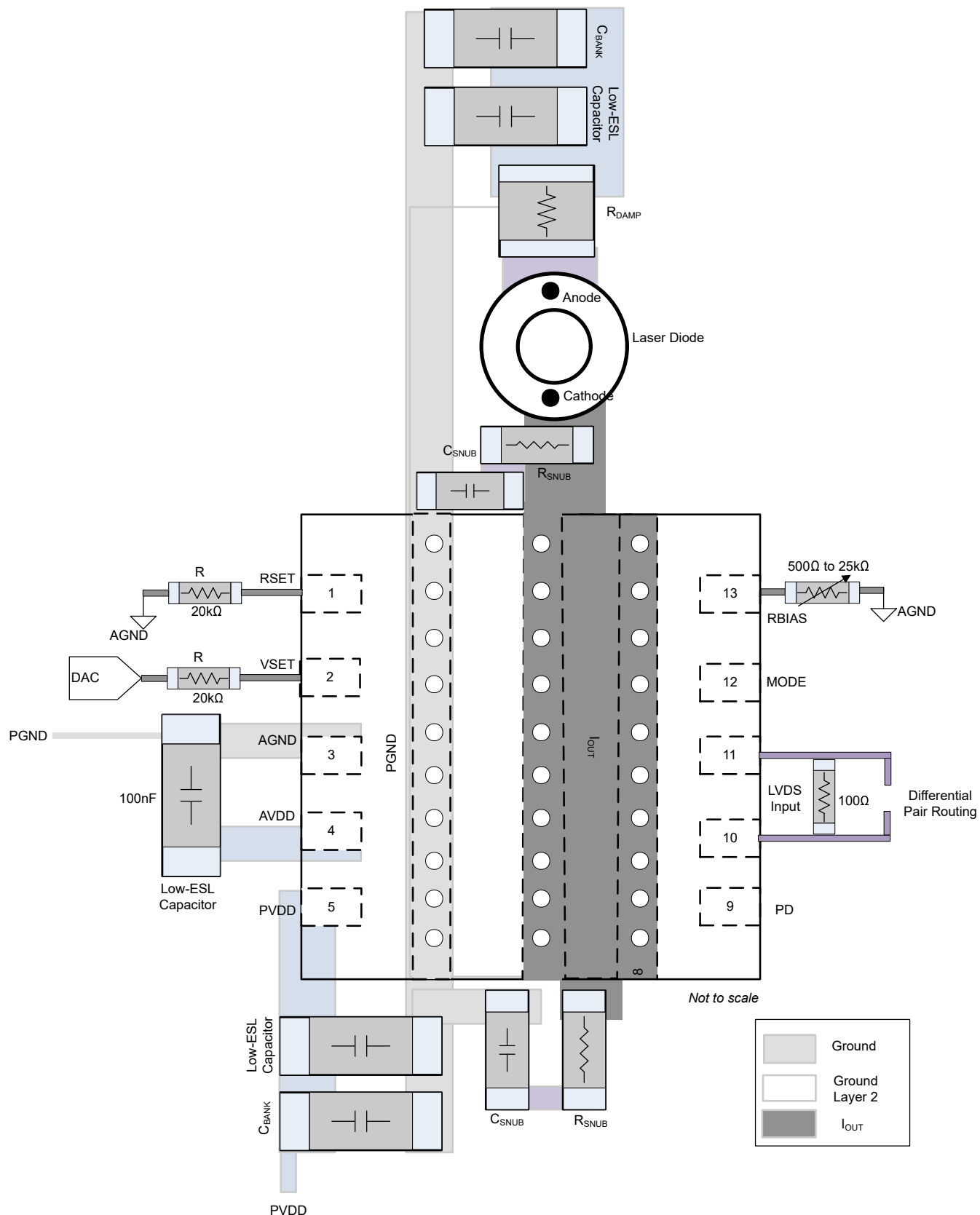


図 7-7. レイアウト例—TO220 パッケージ

8 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

8.3 商標

HotRod™ and テキサス・インスツルメンツ E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision C (September 2025) to Revision D (November 2025)	Page
• 「特長」の出力電流を 50mA から 5mA に変更.....	1
• 表 4-1「ピンの機能」で、低電流を 50mA から 5mA に変更.....	3
• 「推奨動作条件」で、VSET を 0.1V から 0.01V に変更.....	4
• 「低電流モードの電気的特性、MODE=0」で、I _{OUT} を 0.05A から 0.005A に変更.....	5
• 「低電流モードの電気的特性、MODE=0」で、VSET を 0.1V から 0.01V に変更.....	5
• 低電流モード (MODE = 0) で、V _{SET} を 0.1V から 0.01V に、I _{OUT} を 50mA から 5mA に変更.....	18

Changes from Revision B (May 2025) to Revision C (September 2025)	Page
• タイトルを更新.....	1
• 「特長」で立ち上がり時間を 1ns から 800ps に変更.....	1
• 「特長」のパルス列を「最大 250MHz」から「DC から 250MHz」に変更.....	1
• 「特長」でモノリシックレーザードライバを追加した結果、外部 FET が不要になりました.....	1
• 「概要」の文章を明確化のため更新.....	1
• 50mA から 5mA に可変電流を、対応する V _{SET} をそれぞれ 100mV ~ 10mV の範囲で更新	5
• I _{OUT} の精度を±12% から ±14.5% に更新.....	5
• I _{OUT} の精度を ±9% から ±10.5% に更新.....	7
• 静止電流を 23mA から 23.5mA に更新.....	7
• 図 5-29、伝搬遅延と温度との関係および 5-30、3 つの温度キャリブレーション後の伝搬遅延誤差を追加.....	8
• 図 5-1、V _{SET} を I _{OUT} の伝達特性に、5-2、V _{SET} を I _{OUT} の伝達特性に更新.....	8
• 伝搬遅延と温度を追加.....	16
• LMH13000 を使用した自動電力制御ループを追加.....	23

Changes from Revision A (March 2025) to Revision B (May 2025)	Page
• 文書のステータスを事前情報 (プレビュー) から量産データ (アクティブ) に変更.....	1

10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LMH13000RQER	Active	Production	WQFN-HR (RQE) 13	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	L13K

- (1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- (2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- (3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- (4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- (5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- (6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LMH13000RQER	WQFN-HR	RQE	13	3000	330.0	12.4	3.3	3.8	1.2	8.0	12.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LMH13000RQER	WQFN-HR	RQE	13	3000	367.0	367.0	35.0

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.

- 

PADS 6-8
87% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA
SCALE: 20X



**TEXAS
INSTRUMENTS**
www.ti.com

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月